Engiish Abstract

Japanese Patent Publication No. 06-294,566

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

. . (. Citation 3

(11)Publication number:

06-294566

(43)Date of publication of application: 21.10.1994

(51)Int.Cl.

F25D 9/00 F25D 1/00 // H01L 21/302

(21)Application number: 05-079616

(71)Applicant : TEISAN KK

(72)Inventor: YOKOKI KAZUO

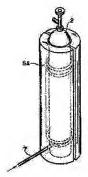
(54) GAS CYLINDER COOLER FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR

06.04.1993

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To provide a gas cylinder cooler for the production of semiconductors which enables the checking of cost of the cooler remarkably and moreover, the reducing of complicated maintenance work, CONSTITUTION: A cooling jacket 5A is fitted into a cylinder 2 for storing a liquefied gas surrounding it. With the jetting of compressed air for cooling into the cooling jacket 5A, air is made to pass through a spiral passage pipe within the cooling jacket 5A to cool the cylinder 2 from the bottom to top. Thereafter, the air is discharged outside to meet a relationship of temperature(ambient temperature of supply line of the cylinder 2. This enables the prevention of a gas for the production of semiconductors from stagnating in the supply line associated with a difference in the temperature in the perimeter of the cylinder 2, a semiconductor production apparatus or the supply line thereby holding back the cost of the cooler significantly while reducing burden from complicated maintenance work.



度をその周囲の温度に比べ-3°C~-5°C冷却すれ ば十分なのに、オーバースペック(恒温化)の問題が生 じるという欠点があったが、本発明に係る空冷の場合に は、オーバースペックの問題を確実に解消するととがで きる.

【0032】さらにまた、本発明に係る空冷の場合に は、冷却ジャケット5Aを薄く構成でき、しかも、水漏 れ対策や錆対策等を施す必要が全くないので、繁雑なメ ンテナンス作業の作業負担を軽減することが可能とな

【0033】次に、図3は本発明の他の実施例を示すも ので、この場合には、シリンダ2の外周面の一部に、平 面ほぼ溝形のスタンド支柱5Bを複数のパンド9で重合 して立設し、とのスタンド支柱5円の立面下部には、流 入バイブ7を接続しており、冷却用の空気を矢印で示す 下部から上部方向に流通させるようにしている。 【0034】本実施例では上記実施例のようにシリンダ

2の全外周面を囲繞していないが、シリンダ2の温度く 供給ライン4の周囲温度の関係にできるので、シリンダ 2、半導体製造装置3、又は、供給ライン4の周囲の温 20 度の相違に伴う供給ライン4内における半導体製造用ガ スの渋滞を防止することができるとともに、冷却装置の コストの大幅な抑制が期待できるのは明白である。

【0035】尚、上記諸実施例では、円筒形の冷却ジャ ケット5Aや満形のスタンド支柱5Bを使用するものを 示したが、空冷という要件を満たすものであれば、平面 ほぼ茶碗形等の形状・構造等に構成しても上記諸実施例 と同様の作用効果を奉する。

[0036]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、シリンダ 30 5 B…スタンド支柱(周壁) を囲繞する周壁に、断熱膨脹により冷却された空気を流 入させるとともに、シリンダを冷却した空気を外部に排来

*出し、シリンダの温度<供給ラインの周囲温度の関係に するので、シリンダ、半導体製造設備、又は、供給ライ ンの周囲の温度の相違に伴う供給ライン内における半導 体製造用ガスの渋滞を確実に防止することができるとと もに、冷却装置のコストの大幅な抑制が期待できるとい う顕著な効果がある。

【0037】さらに、空冷を活用するので、水漏れ対策 や錆対策等を施す必要が全くなく、繁雑なメンテナンス 作業の作業負担度を大幅に軽減することが可能になると

10 いう格別の効果がある。 【図面の簡単な説明】

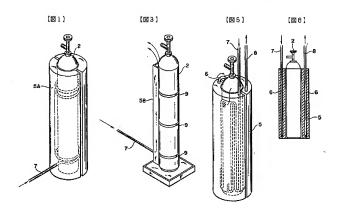
- 【図1】本発明に係る半進体製造用のガスシリンダ冷却 装置の一字論例を示す斜視図である
- [図2] 本発明に係る半導体製造用のガスシリンダ冷却 装置の一実施例を示す断面説明図である。
- 【図3】本発明に係る半導体製造用のガスシリンダ冷却 装置の他の実施例を示す斜視図である。
- 【図4】半導体製造用のガス供給システムを示す全体説 明図である。
- 【図5】従来における半導体製造用のガスシリンダ冷却 装置を示す斜視図である。

「図6」従来における半進体製造用のガスシリンダ冷却 装置を示す断面説明図である。

【符号の説明】 1…シリンダキャビネット

- 2…シリンダ
- 3…半導体製造装置(半導体製造設備)
- 4…供給ライン
- 5·5A…冷却ジャケット(周壁)
- - 6・6 A …流涌パイプ

[図2] [図4]



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出順公開番号 特開平6-294566

(43)公開日 平成6年(1994)10月21日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
F 2 5 D	9/00	Z	7409-3L		
	1/00	Z	7409-3L		
# H01L	21/302	В	9277-4M		
" 11012	D2, 04D	_			

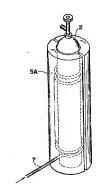
		審查請求	未請求 請求項の数1 〇L(全 5 貝)	
(21)出願番号	特類平5-79616	(71)出願人	(71)出願人 000 109428 テイサン株式会社	
(22)出顧日	平成5年(1993)4月6日		東京都港区虎ノ門1丁目15番12号 日本瓦 斯協会ピル内	
		(72)発明者	横木 和夫 東京都江東区東雲一丁目 9番 1号 テイサ ン株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 長谷川 芳樹 (外5名)	

(54) 【発明の名称】 半導体製造用のガスシリンダ冷却装置

(57)【要約】

[目的]冷却装置のコストを着しく抑制し、しかも、繁 雑なメンテナンス作業を軽減し得る半導体製造用のガス シリング冷却装置を提供する。

【構成】液化ガスを貯えるシリンダ2に、冷却ジャケッ ト5Aを囲続状態で嵌入する。そして、冷却ジャケット 5Aに冷却用の圧縮空気を噴射するとともに、冷却ジャ ケット5Aの内部における螺旋状の流通パイプに該空気 を流通させてシリング2を下部から上部へと冷却し、そ の後、該空気を外部に排出し、シリンダ2の温度<供給 ラインの周囲温度の関係にする。こうすれば、シリング 2、半導体製造装置、又は、供給ラインの周囲の温度の 相違に伴い、供給ライン内で半導体製造用ガスが渋滞す るのを防止でき、冷却装置のコストを大幅に抑制できる とともに、繁雑なメンテナンス作業の作業負担を軽減し 得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半端体の製造に使用され室温では殆ど蒸気 圧値が大気圧値に近似する半導体製造用ガスと、この半 導体製造用ガスを充填したシリングと、このシリングか ら半端体製造設備に該半海体製造用ガスを供給する供給 ラインと、少なくとも該シリングの一部を開む合お到業

ノインと、ブないとはかいます。 と、この冷却整き液温して該シリング内の半等体製造用 ガえを冷却するや却空気とを備え、シリング、半等体製 造塑機、双は、総合ラインの周囲の趣度の相応に発 給ライン内における半導体製造用ガスの供給の渋滞を防 止することを特徴とする半導体製造用ガスの供給の渋滞を防 加装値。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、室温では殆ど素気圧値 が大気圧値に近似する半等体製造用のガスを貯えたガス シリングを空気で冷却する半導体製造用のガスシリング 冷却接着に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体製造用のガス供給システムは、図 4に示す如く、シリングキャビネット1から半導体製造 用ガスを半導体製造装置3に供給ライン4を介して供給 するようにしている。

【0003】(集結設備である上記シリングキャビネット 1は、図示しない供給施設内に設置され、その内部に は、ボンベであるリングタンが1本、吸いは、子偏を含 めた複数本が収納されており、このシリング2には、シ ランや登業等の半導体製造用ガス(図示せず)が完填さ れている。

[0004]また、上記半導体製造装置3は、該供給施設とは別の図示しない半導体製造能数内に設置され、供給ライン4を介して計場したシリングキャビネット1のシリング2と接続されており、通常は不規則に停止・始動して半等体を製造する優騰を有している。

【0005】さんに、上記保給ライン4は、半導体製品 用ガスを供給する作用を含むが、設置場所やスペース等の関係から、図4に示す如く、低倍路4 aを備えた高低の付いた状態で配管されるとともに、屋内の側、野外に移腹で表面が動物がで配管されるとともに、屋内の側、野外に移してある。【0006】然して、シリングキャビネット1、半導体製造業置 及び供給ライン4は、それぞれ別の建設内に設置、又は、医管されるので、部分物に温まったり、冷えたりも等、ガス供給システム全体に亘る温度分布が一字化しないのが鑑賞である。

[0007]ところで、半等体の製造に膨しては、上記シランや空業等のガスの他に、室温では発生素気圧値が 大気圧値に近射する液化ガス、接管すれば、20 5辺 の室温では発生の気圧の液化ガス(例えば、SIH。C 1。ガス、WF。ガス、BC1。ガス、CIF。ガス、 F123ガス等)の使用されることが少なくない。 【0008】この液化ガスを上記半導体製造用のガス供 給システムに使用した場合、半導体製造装置3の運転中 には問題をそれほど生じさせないが、半導体製造装置3 の停止後には、以下に述べる大きな問題を生じさせるこ とがあった。

【0009】脚ち、液化ガスからなる半導体製造削ガス は、その特徴からレギュレーク無して半導体製造業 風のボンブにより吸引状態で半導体製造業署 3.供給さ れるが、不規則な停止と始動を繰り返す半導体製造装置 3.の停止に伴い、その一部が供給ライン4に残留するこ ととなる (四4 参照)。

【0010】 半導体製造装置3が停止しても、シリング キャセネット1の輸出供給や限、即ち、シリングキャビ ネット1内のバルブは開のままであるため、残留した半 導体製造用ガスは、時間の胚当に伴い他和販売になる が、接続ライン4がシリング2の周囲温度に比べれえる 場所に設置されている場合には、液化し、液化したガス が管域に溜まることとなる。

【0011】然して、この深望は時間の経過に鈍い増加 して悪趣の場合接針をむり、この流移を除去しないまま マ半導体験追用ガスの供給を前前すると、半導体製造用 ガスの供給が著しく困難化するという問題が生じる。また、液計にまで至らない場合でも、管内に流が形成され ることにより、ガス供給が不安定になるという問題が生 じる。

【0012】この問題の解消には、シリングキャビネット1、半導体製造装置3及び供給ライン4を一箇所に配 設して相互間の距離を挟め、システム全体の温度分布を 中的でもという方法が考えられる。

【0013】しかしながら、この方法は、設置スペース 等の関係から供給ライン4を高低の付いれ、標を野外に 接触な配管状態で配管せざるを得ない場合には、採用し 得ず、又、温度刺傳のための高値な削削機器を必要不可 欠にするという欠点がある。

【0014】そこで、上記問題の解消に際しては、従 来、図を図るに示す如く、シリンダ2の問題に冷却ジャケット5を設置し、この冷却ジャケット5には、木や アルコール等の冷却水を流えさせるとともに、シリンダ 2を冷却した冷却水を外部に流出させ、シリンダ2の温 度く供給ライン4の周囲温度の関係にするようにしてい

【0015】上記冷却ジャケット5は、同圏に示す如 く、2つに分割可能な平面はほど全形に構成され、その 内部には、均一に冷却する側点からほぼ波形に蛇行した 流通バイア6が通常内蔵されており、シリング2に囲縦 状態で嵌入されている。

【0016】そして、冷却ジャケット5の上部には、冷 却水を図示しない恒温槽から流通パイプ6に流入させる 流入パイプ7が接続されるとともに、冷却水を流通パイ プ6から外部に排出する流出パイプ8が接続されてい **δ**.

【0017】従って、冷却水は、恒温槽から流入パイプ 7を軽由して冷却ジャナット5内の流電パイプでに順か 流入し、この波形に蛇行した流通パイプ6の速速 シリング2を効率後く冷却し、その核、流道パイプ6か ら流出パイプ8を経由して外部に順次供出され、シリン ダ2の温度をその周囲の温度に比べ、約-3°C~-5 でほど冷却する。

[0018]

【努明が解決しようとする問題】 従来における半導体製造用のガスシリング冷却認識は、以上のように構成され、メリング 2を削削する冷却ジャケット5に、冷却水を拡入させ、この冷却水を小部に排出しているので、冷却設置が外部に大型化・複雑化して動や方面に (150万~100万) になってしまうとともに、頻繁に実施なメンテナンスを強いられると言う問題点があった。

[0019] 本発明は上記に鑑みなされたもので、シリンダを冷却する冷却装置のコストを著しく抑制し、しかも、緊急なメンテナンス作業を軽減することのできる半導体製造用のガスシリング冷却装置を提供することを目的としている。

[0020]

【課題を解決するための予段】本祭別においては上述の 目的を達成するため、半導体の要認在使用され登画では あど魔な年度が大圧圧値に成ける半導体製造用ガス と、この半導体製造用ガスを充填したシリンダル、この シリンゲから半導体製造機に該半導体製造用ガスを 検討する機構ラインと、少なくとも該シリンダの一部を回 返用ガスを冷却する冷却日本原変とを信え、シリンダルの半導体製 選用ガスを冷却する冷却日本原変とを信え、シリンダ 、半導体製造設備、又は、供給ラインの周囲の速度の 相違に伸う供給ライン内における半導体製造用ガスの供 格の機器を防止するようにしている。

[0021]

【作用】 本列門によれば、冷期用圧解管気は、外部から 周腔内に冷却用噴射 イズルを介して噴射送給される。こ の時、ズルから耐熱筋腫することにより、空気流冷却さ れる。このようにして冷却された空気は、周壁かを順か、 流通してシリンダを下部から上が一次を対し、 然る後、周壁から外部に順次排出され、シリングの温度 をその周囲の温度に比べ、- 3° C~-5° C冷却す る。

[0022]

【実施例】以下、図1乃至図4に示す一実施例に基づき 本発明を詳説する。

【0023】本発明に係る半導体製造用のガスシリング 冷却装置は、シリンゲ2の周囲に冷却ジャケット5Aを し、この冷却ジャケット5Aには、冷却用の圧縮空 気を噴射するとともに、シリンゲ2を冷却した空気を大 部に排出し、シリンダ2の温度く供給ライン4の周囲温 度の関係にするようにしている。

[0024] ボンベである上記シリング2は、その内部 に室温では殆ど療気圧値が大気圧値に対反する飛び 丸、焼言すれば、 20° 近辺の空温では殆どり気にの液 化ガス(例えば、 $Si \, H_2 \, Cl_1$ ガス、 WF_0 ガス、B Cl_1 ガス、 Cl_F 。ガス、F123 ガス等)が充填さ れ、供給影論であるシリングキャビネット1の内部に収 納されている。

[0025] また、上記冷却ジャケット5人は、関図に 示すがに、ステンレス帯の対賛から2つに分析可能な円 簡形に構成され、その内部には、冷却用の圧略空気(図 示せず)を下部から上部に順次流通させる場象性の流通 バイブらんが内臓されており、シリング2に囲帳状態で 終えされている。

[0026] さらに、冷却ジャケット5名の外側面下部 には、冷却用の圧縮空気を流通バイプ6名に噴射・送冷 させる流力バイブ7が接続されている。然して、空気 は、流力バイブ7から流過バイプ6名を掘れして冷却ジャケット5名の上部から排出され、シリングキャビネッ ト1の内部に排出されるようになっている。

10028] 上記構成によれば、シリング2を間轄する 冷却ジケット 5 Aに、冷却水の代わりに断熱即能によ 冷却された空気を外部に排出し、シリング2の温度で保給す イン4の別田温度の関係にするので、シリング2、半端 保製金装筒 3 又は、保給ライン4の別団の温度の附近 に伴う操持ライン4内における半端体製造用ガスの渋滞 を防止することができるとともに、冷却感覚のコスカ 大概定切削、保料的には変い円程度)が明符できる。

【0029】具体的には、水冷の場合には、冷却ジャケット5Aを厚く構成し、水漏北対策や錆対策等を施さなければならず、しかも、冷却装置の件展製備を設置するスペースを大きく確保せざるを得ない。

【0030】 これに対し、本郷明に高る整体の場合には、冷却ジャケット5 Aを薄く構成でき、水漏れ対策冷 鏡対明等を譲すむ要が全くなく、しかも、半導体製造施 限内の圧離空気を簡単に利用することができるので、効 地域面の相談的の表徴ズペースと大脈に縮小すること が可能となる。また、水の場合のように高値で研究装置 は不要で、ただシリングキャモネット1 の行態に放出す るだけて良く、構造が他めてシンプルである。

【0031】さらに、水冷の場合には、シリング2の温

度をその周囲の温度に比べー3°C~-5°C冷却すれば十分なのに、オーバースペック(恒温化)の問題が生 じるという欠点があったが、本発明に係る空冷の場合に は、オーバースペックの問題を確実に解消することがで きる。

【0032】さらにまた、本発明に係る空冷の場合に は、冷却ジャケットらAを薄く構成でき、しかも、水漏 れ対策や爺対策等を能す必要が全くないので、繁雑なメ ンチナンス作業の作業負担を軽減することが可能とな

る。 【0033】次に、図3は本発明の他の実施例を示すも ので、この場合には、シリンダ2の外面面の一部に、平 面はは滞形のスタンド支柱5日を複数のパンドラで電合 して立張し、このスタンド支柱5日の立面下部には、流 入バイフアを接続しており、冷却用の空気を失和で示す 下部から上断りに流面させるようにしている。

(0034] 本実施例では上記支施例のようにシリング 2の余外周前を開始していないが、シリンダ2の温度ぐ 総持ライン4の周間温度の関係にできるので、シリンダ 2、半導体製造版習3、又は、供給ライン4の周囲の温度の相違に伴う供給ライン4内における半導体製造制力 スの渋滞を防止することができるととに、冷却影響の コストの大振な身間が開持できるのは明白である。 [0035] 海、足記軽実験所は、門崎形の始却ジャ ケット5Aや構形のスタンド支柱5Bを使用するものを 示したが、空冷という要件を消化するのれば、平面 は耳弦を保健等の関係・積密では構成しても上記速変換例

と同様の作用効果を奏する。 【0036】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、シリング を囲続する周健に、断熱膨脹により冷却された空気を流 えさせるとともに、シリングを冷却した空気を外部に排 出し、シリンダの温度く供給ラインの期間温度の関係に するので、シリンダ、半線体製造設備、又は、保格ライ の問題の温度の相違化中)と終うイン内における半導 体製造用ガスの渋滞を確実に防止することができると もに、冷却装置のコストのく帽な抑制が期待できるとい 実際を必要とかる。

【0037】さらに、空冷を活用するので、水漏れ対策 や錆対策等を施す必要が全くなく、繁雑なメンテナンス 作業の作業負担度を大幅に軽減することが可能になると いう格別の効果がある。

【関面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係る半導体製造用のガスシリング冷却 装雷の一実施例を示す斜視図である。
- 【図2】本発明に係る半導体製造用のガスシリンダ冷却 装置の一実施例を示す断面説明図である。
- 【図3】本発明に係る半導体製造用のガスシリング冷却 装置の他の実施例を示す斜視図である。
- [図4]半導体製造用のガス供給システムを示す全体説明図である。
- 【図5】従来における半導体製造用のガスシリング冷却 装置を示す斜視図である。
- 【図6】従来における半導体製造用のガスシリング冷却 装置を示す断面説明図である。

【符号の説明】

- 1…シリンダキャビネット
- 2…シリンダ 3…半萬体販売装置(半導体製造設備)
- 4…供給ライン
- 5 · 5 A…冷却ジャケット(周壁)
- 5 B…スタンド支柱(周壁)
- 6 · 6 A…流通パイプ

